

平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年2月10日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社 石井工作研究所

コード番号 6314 URL <http://www.i-kk.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 石井見敏

問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務経理部長

(氏名) 辻野治弘

TEL 097-544-1001

四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の業績(平成23年4月1日～平成23年12月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	1,774	△11.3	△323	—	△286	—	△219	—
23年3月期第3四半期	1,999	92.7	△79	—	1	—	32	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	△28.21	—
23年3月期第3四半期	4.16	—

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	6,703	—	5,530	—	—	82.5
23年3月期	6,930	—	5,862	—	—	84.6

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 5,530百万円 23年3月期 5,862百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
23年3月期	—	0.00	—	10.00	10.00
24年3月期	—	0.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注)直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,525	△15.2	△420	—	△377	—	△340	—	△43.74

(注)直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期3Q	7,800,000 株	23年3月期	7,800,000 株
24年3月期3Q	26,922 株	23年3月期	26,866 株
24年3月期3Q	7,773,123 株	23年3月期3Q	7,773,154 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P. 1「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	1
(1) 経営成績に関する定性的情報	1
(2) 財政状態に関する定性的情報	1
(3) 業績予想に関する定性的情報	1
2. サマリー情報（その他）に関する事項	2
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
3. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	4
第3四半期累計期間	4
(3) 継続企業の前提に関する注記	5
(4) セグメント情報等	5
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	6
(6) 重要な後発事象	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によって急速に悪化したあと、サプライチェーンの回復もあって持ち直し傾向にありましたが、円高の定着や海外景気の回復鈍化、電力供給制約、タイ洪水の影響等により、景気に停滞感が広がってきております。

半導体業界では、スマートフォンや電子タブレット端末の需要増加に伴って、電子部品やデバイスも増加すると期待されましたが、PCメーカーが主要な電子部品であるDRAMの過剰在庫圧縮を進めており、加えてタイの洪水被害によるPC生産台数の下振れ懸念からDRAMの需要が減退したこともあり、半導体製造装置市場は調整局面が続いており、投資抑制が大勢となっております。

このような経済状況のもとで、当社は半導体関連事業を中心に活発な受注活動と納期短縮を推進し、お客様のニーズに即した製品開発に努めるとともに、購入品や材料等の仕入価格低減による経費節減を図ったものの、受注が伸び悩み、業績を回復軌道に乗せることは叶いませんでした。

この結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高17億7千4百万円（前年同四半期比11.3%減）となり、営業損失3億2千3百万円（前年同四半期は7千9百万円の営業損失）、経常損失2億8千6百万円（前年同四半期は1百万円の経常利益）、四半期純損失2億1千9百万円（前年同四半期は3千2百万円の四半期純利益）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①半導体関連事業

半導体業界の設備投資の動向を映じて受注は伸び悩み、全売上高の98.1%を占める半導体関連事業の売上高は、前年同四半期に比べ11.1%減少し、17億4千万円となりました。

②その他

不動産・建築関連事業及び浄水事業の売上高は3千3百万円（前年同四半期比19.5%減）となりました。

(2) 財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第3四半期会計期間末における流動資産は35億9千9百万円となり、前会計年度末に比べ8百万円減少いたしました。これは受取手形及び売掛金が5億9百万円増加したものの、現金及び預金が5億7千7百万円が減少したことによるものであります。固定資産は31億3百万円となり、前会計年度末に比べ2億1千9百万円減少いたしました。これは主に投資その他の資産が1億8千6百万円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は67億3百万円となり、前会計年度末に比べ2億2千7百万円減少いたしました。

(負債)

当第3四半期会計期間末における流動負債は5億6千5百万円となり、前会計年度末に比べ1億5千5百万円増加いたしました。これは主に引当金が4千8百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1億7千2百万円増加したことによるものであります。固定負債は6億6百万円となり、前会計年度末に比べ5千万円減少いたしました。これは主にその他固定負債が6千2百万円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、11億7千2百万円となり、前会計年度末に比べ1億4百万円増加いたしました。

(純資産)

当第3四半期会計期間末における純資産合計は55億3千万円となり、前会計年度末に比べ3億3千2百万円減少いたしました。これは主に当期純損失の計上2億1千9百万円及び剰余金の配当7千7百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は82.5%（前会計年度末は84.6%）となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

第3四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成23年11月11日付当社「平成24年3月期第2四半期決算短信（非連結）」にて発表いたしました平成24年3月期の業績予想を修正しました。

詳細につきましては、本日（平成24年2月10日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第3四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法

当第3四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

3. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,986,032	1,408,824
受取手形及び売掛金	890,234	1,399,481
商品及び製品	199,842	192,825
仕掛品	277,494	327,703
原材料及び貯蔵品	144,861	151,757
その他	133,537	143,618
貸倒引当金	△24,350	△24,820
流動資産合計	3,607,653	3,599,391
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	740,218	718,778
土地	1,820,173	1,820,173
その他(純額)	166,167	153,820
有形固定資産合計	2,726,560	2,692,772
無形固定資産	30,778	31,504
投資その他の資産	565,726	379,351
固定資産合計	3,323,065	3,103,628
資産合計	6,930,718	6,703,020
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	251,303	423,701
未払法人税等	11,519	5,977
引当金	67,440	19,130
その他	80,507	117,113
流動負債合計	410,769	565,922
固定負債		
役員退職慰労引当金	466,216	477,778
その他	191,065	128,872
固定負債合計	657,282	606,650
負債合計	1,068,051	1,172,573
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,186,300	1,186,300
資本剰余金	2,757,259	2,757,259
利益剰余金	1,948,787	1,651,789
自己株式	△11,423	△11,434
株主資本合計	5,880,923	5,583,914
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△18,256	△53,468
評価・換算差額等合計	△18,256	△53,468
純資産合計	5,862,667	5,530,446
負債純資産合計	6,930,718	6,703,020

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
売上高	1,999,940	1,774,037
売上原価	1,558,899	1,634,042
売上総利益	441,040	139,994
販売費及び一般管理費	520,465	463,386
営業損失(△)	△79,424	△323,392
営業外収益		
受取利息	2,326	1,899
受取配当金	5,764	6,812
投資不動産売却益	64,655	22,454
その他	9,647	6,675
営業外収益合計	82,393	37,842
営業外費用		
為替差損	298	323
減価償却費	1,139	458
営業外費用合計	1,438	782
経常利益又は経常損失(△)	1,530	△286,332
特別利益		
貸倒引当金戻入額	4,100	—
固定資産売却益	—	895
特別利益合計	4,100	895
特別損失		
固定資産除却損	548	45
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	652	—
特別損失合計	1,200	45
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	4,430	△285,482
法人税、住民税及び事業税	3,551	3,551
法人税等調整額	△31,494	△69,767
法人税等合計	△27,942	△66,216
四半期純利益又は四半期純損失(△)	32,373	△219,266

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第3四半期累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント	その他 (注)	合計
	半導体関連事業		
売上高			
外部顧客への売上高	1,958,749	41,191	1,999,940
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—
計	1,958,749	41,191	1,999,940
セグメント利益又は損失(△)	196,227	△54,811	141,415

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産・建築関連事業及び浄水事業等を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	196,227
「その他」の区分の損失	△54,811
全社費用(注)	△220,840
四半期損益計算書の営業損失(△)	△79,424

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第3四半期累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント	その他 (注)	合計
	半導体関連事業		
売上高			
外部顧客への売上高	1,740,894	33,142	1,774,037
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—
計	1,740,894	33,142	1,774,037
セグメント損失(△)	△56,836	△56,217	△113,054

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産・建築関連事業及び浄水事業等を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△56,836
「その他」の区分の損失	△56,217
全社費用(注)	△210,338
四半期損益計算書の営業損失(△)	△323,392

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

- (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

- (6) 重要な後発事象
該当事項はありません。